

2017年10月27日

トッパンフォームズとMTES社、IoT分野で資本提携 通信方式LoRaとRFIDを組み合わせたIoTソリューションの開発を推進

デジタルハイブリッドのトッパン・フォームズ株式会社（以下トッパンフォームズ）は、MTES株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 隆朗、以下MTES社）が実施する第三者割当増資の一部を引き受け、資本提携契約を締結しました。

MTES社は低消費電力ながら長距離伝送できる通信方式LoRa^{*1}を活用したIoTソリューションをエネルギーや介護の分野で提供しています。トッパンフォームズは日本国内で研究開発・製造を行うなど高い機能性や品質を持つRFID分野を中心としたIoTソリューションを提供しています。そのRFID（無線通信による個体認識）技術とMTES社のLoRa技術を組み合わせ、より適応範囲の広い独自のIoTソリューションの開発を推進し、ITイノベーション事業の強化につなげます。

*1：LoRaとは小電力で広い範囲をカバーするLPWA（Low Power Wide Area）通信規格の一種で、国内では主に920MHz帯を用いる方式。

【提携の目的と今後の展開】

今回の資本提携は両社の強みを組み合わせ、製造や物流、医療・介護などさまざまな分野に適用可能なIoTソリューションの開発・提供を目的としています。

MTES社のLoRa技術は接続堅牢性や高いセキュリティ、最大到達距離（エリアカバレッジ）、データ量の面について特長があります。一方、トッパンフォームズは独自のアンテナ設計技術により、高品質かつお客さまの利用環境に合わせたさまざまなバリエーションのRFIDタグの開発・提供が可能です。

両社のこれらの強みを活かすことで、データの取得から上位システムへのデータ連携までを高いセキュリティ環境のもとに行うことができる拡張性の高いIoTソリューションの開発・提供を推進します。そして新たなビジネス基盤を創出することで、トッパンフォームズは関連ビジネスで2020年度35億円の売り上げを目指します。

以上

※ 「デジタルハイブリッド」は、トッパン・フォームズ株式会社の登録商標です。

※ その他記載された製品名などは各社の登録商標あるいは商標です。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

トッパン・フォームズ株式会社 経営企画本部広報部 TEL:03-6253-5730

【参考情報】

■MTES 株式会社について

社 名：MTES 株式会社

代 表 者：代表取締役社長 原田 隆朗

設 立：2015年3月

資 本 金：140,575,000円

所 在 地：東京都中央区新富 1-8-2 MIYAMA ビル 8F

事業内容：EMS(エネルギーマネジメントサービス)事業

環境事業関連製品の開発・製造・販売事業

屋上太陽光発電事業

IoTソリューション事業

CNT 環境関連製品の開発・販売

U R L：<http://mte-s.co.jp/>